

Title (en)

Electromechanical relay housing, relay, switching assembly and assembly for supporting the electromagnetic relay

Title (de)

Gehäuse für elektromechanisches Relais, Relais, Schaltanordnung und Halterungseinheit für elektromechanisches Relais

Title (fr)

Boîtier de relais électromécanique, relais, ensemble de commutation et ensemble de support de relais électromagnétique

Publication

EP 2634784 A1 20130904 (FR)

Application

EP 13156962 A 20130227

Priority

- FR 1251805 A 20120228
- FR 1260295 A 20121029

Abstract (en)

The housing (3) has a switching element (2) provided with portions for switching electrical contacts. A hollow portion (4) is provided to receive the switching element. Fixing elements (5a1, 5a2, 5b1, 5b2) are provided to fix hollow portion to a support (6). The fixing elements are provided with fixing unit comprising a surface bearing on the support. A connection unit (51) is allowed to connect the fixing unit to the hollow portion and is designed to deform in flexion along principal direction (D2). Independent claims are included for the following: (1) an electromagnetic relay; (2) a switching assembly; and (3) an assembly for supporting an electromagnetic relay.

Abstract (fr)

Ce boîtier (3) est prévu pour loger un relais électromécanique (1) comprenant un organe de commutation (2) incluant des pièces de commutation de contacts électriques, mobiles en translation selon une direction principale (D2). Le boîtier comprend : - un corps creux (4) de réception de l'organe de commutation (2), - des éléments (5a1, 5a2, 5b1, 5b2) de fixation du corps sur un support (6). Les éléments de fixation comprennent chacun une partie de fixation présentant une surface (S52) d'appui sur le support et des moyens (53) de fixation sur le support. Les éléments de fixation comprennent en outre une partie de liaison (51) reliant la partie de fixation au corps (4) et les parties de liaison (51) sont conçues pour se déformer en flexion au moins selon la direction principale (D2). L'invention concerne également un ensemble de support comprenant un tel boîtier (3) et des éléments d'amortissement.

IPC 8 full level

H01H 3/60 (2006.01); **H01H 50/04** (2006.01); **H01H 50/30** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01H 3/60 (2013.01 - EP US); **H01H 45/04** (2013.01 - US); **H01H 50/043** (2013.01 - EP US); **H01H 50/305** (2013.01 - EP US)

Citation (applicant)

JP 2006155972 A 20060615 - OHTSUKA POLYTECH CO LTD, et al

Citation (search report)

- [XDA] JP 2006155972 A 20060615 - OHTSUKA POLYTECH CO LTD, et al
- [A] DE 741838 C 19431118 - PHILIPS PATENTVERWALTUNG
- [A] US 2268882 A 19420106 - LILJA EDGAR D

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 2634784 A1 20130904; **EP 2634784 B1 20150909**; CN 103295841 A 20130911; CN 103295841 B 20170908; US 2013222085 A1 20130829; US 8653922 B2 20140218

DOCDB simple family (application)

EP 13156962 A 20130227; CN 201310064127 A 20130228; US 201313780159 A 20130228